

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-12

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	中泰证券、中邮证券、长城基金、泰康资产、泰康基金、易方达基金、新华资产、银华基金、景顺长城基金、华夏久盈、工银瑞信基金
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；投资者关系经理：郭家旭
时间	2025年3月28日
地点	机构投资者所在地（北京）、电话及网络会议
形式	实地调研、电话及网络会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍 2024 年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。</b></p> <p>2024 年，PCB 业务实现主营业务收入 104.94 亿元，同比增长 29.99%；毛利率 31.62%，同比增加 5.07 个百分点。PCB 业务充分把握算力以及汽车电子市场的机遇，实现营收和利润的稳健增长。PCB 业务营收层面的增长贡献主要集中在集中在通信领域 400G 及以上的高速交换机、光模块产品需求增长；数据中心领域 AI 服务器及相关配套产品需求增长，以及服务器总体需求显著回温；汽车电子领域电动化/智能化趋势促进订单需求持续释放。</p> <p>PCB 业务毛利率的增长得益于营收规模增加，PCB 工厂产能利用率提升，AI 相关领域订单需求增长助益 PCB 业务产品结构优化。同时，公司针对性开展多项运营管理能力提升工作，通过提升原材料利用率、前置引导客户设计、优化能源管理等多种方式强化成本竞争力，并针对部分瓶颈工序进行技术提效，保障高效产出，对 PCB 业务毛利率的提升起到正向作用。</p>

**Q2、请介绍 2024 年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。**

2024 年,封装基板业务实现主营业务收入 31.71 亿元,同比增长 37.49%;毛利率 18.15%,同比减少 5.72 个百分点。封装基板业务在全球基板行业温和修复的环境下,加大市场拓展力度,加快推进新产品和新客户导入,推动订单较去年增长。封装基板业务毛利率的下降主要由于广州封装基板项目爬坡、金盐等部分原材料涨价,叠加下半年 BT 类基板市场需求波动、基板工厂产能利用率有所下降等因素共同影响。

**Q3、请介绍 FC-BGA 封装基板产品特点、主要应用场景及公司目前产品能力。**

FC-BGA 封装基板具备高多层、高精细线路等特性,主要应用于搭载 CPU、GPU 等逻辑芯片,芯片产品具体应用场景取决于客户自身需求。公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力,18、20 层产品具备样品制造能力,各阶产品相关送样认证工作有序推进,20 层产品目前在客户端认证环节已取得比较好的结果。

**Q4、请介绍公司广州封装基板项目连线爬坡进展。**

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线,产品线能力持续提升,产能爬坡稳步推进,已承接包括 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单,但总体尚处于产能爬坡早期阶段,重点仍聚焦能力建设,由此带来的成本及费用增加,对公司利润造成一定负向影响。

**Q5、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。**

公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作,产品下游应用以通信设备为核心(覆盖无线侧及有线侧通信),重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子(聚焦新能源和 ADAS 方向)等领域,并长期深耕工控、医疗等领域。其中,数据中心领域在 2024 年度成为公司 PCB 业务继通信领域之后,第二个达 20 亿元级订单规模的下游市场。

**Q6、请介绍公司 PCB 业务在 PTFE 方面的布局情况。**

PTFE 材料在高频 PCB 领域已有比较成熟的应用,公司在通信、汽车 ADAS 等高频应用场景已有相关成熟 PCB 产品。行业对 PTFE 在高速 PCB 领域的开发和大批量应用尚处在早期阶段,公司对行业前沿技术及应用保持关注与研究,已具有相应技术储备。

	<p><b>Q7、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。</b></p> <p>公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。</p> <p><b>Q8、请介绍公司近期产能利用率情况。</b></p> <p>公司 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率仍保持在高位运行；封装基板业务受近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率环比第四季度略有提升。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>